

### 請求の範囲

- [請求項1] 銅の融点より250～700℃高い温度に加熱した銅溶湯を落下させながら、非酸化性雰囲気中において高压水を吹き付けて急凝固させることを特徴とする、銅粉の製造方法。
- [請求項2] 前記加熱が非酸化性雰囲気中において行われることを特徴とする、請求項1に記載の銅粉の製造方法。
- [請求項3] 前記高压水が純水またはアルカリ水であることを特徴とする、請求項1に記載の銅粉の製造方法。
- [請求項4] 前記高压水が水圧60～180MPaで吹き付けられることを特徴とする、請求項1に記載の銅粉の製造方法。
- [請求項5] 平均粒径が1～10 $\mu$ m、(200)面における結晶子径 $D_{x(200)}$ が40nm以上であり、酸素含有量が0.7質量%以下であることを特徴とする、銅粉。
- [請求項6] 前記銅粉の円形度係数が0.80～0.94であることを特徴とする、請求項5に記載の銅粉。
- [請求項7] 前記銅粉のBET比表面積に対する酸素含有量の比が2.0質量%・g/m<sup>2</sup>以下であることを特徴とする、請求項5に記載の銅粉。
- [請求項8] 前記銅粉の(111)面における結晶子径 $D_{x(111)}$ が130nm以上であることを特徴とする、請求項5に記載の銅粉。
- [請求項9] 前記銅粉の熱機械的分析における収縮率1.0%のときの温度が580℃以上であることを特徴とする、請求項5に記載の銅粉。
- [請求項10] 請求項5に記載の銅粉が有機成分中に分散していることを特徴とする、導電性ペースト。
- [請求項11] 前記導電性ペーストが焼成型導電性ペーストであることを特徴とする、請求項10に記載の導電性ペースト。
- [請求項12] 請求項11の焼成型導電性ペーストを基板上に塗布した後に焼成して導電膜を製造することを特徴とする、導電膜の製造方法。